

## 化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム 2019 報告書

実行委員 塩井章久、清田佳美、小野 努、後藤健彦、伊藤大知、山本大吾(文責)

化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム 2019 が 2019 年 1 月 10 日(木)に東京大学にて開催された。本シンポジウムは各種材料プロセスを横断するような共通課題(基盤技術)について議論する場を提供し、基盤技術の体系化を図るとともに、学会と産業界との連携を図ることを目的としたものである。今年度は、接着・粘着技術から、構造接着、異種材料接着、接着プロセス技術、接着評価技術までを一連のトピックとして取り上げ、接着設計と管理に関する基礎現象の理解から接着技術の応用展開まで俯瞰的に捉え、広い分野に共通する基盤技術について議論をした。前回に引き続き企業からの参加者を積極的に募るとともに、関連学会での告知も行った結果、事前登録が 102 名(企業から 32 社 38 名、大学から 13 研究室 64 名)となり、当日参加者数は 92 名という盛会となった。発表の詳細は後述のシンポジウム案内をご参照頂きたい。また、シンポジウム後の懇親会も 40 名近くの参加者があり、活発な意見交換がなされていた。今後も、産学連携や分野を越えた交流の場として、共通基盤技術シンポジウムを継続的に開催することが望まれる。なお、企画から開催に渡り、部会幹事会メンバーのご協力を得たことを記して謝意を表す。



## 補足資料 化学工学会 材料・界面部会 共通基盤技術シンポジウム 2019

主催：化学工学会 材料・界面部会

協賛：(一社)日本接着学会、(公社)高分子学会、(公社)日本化学会、(一社)日本レオロジー学会、

(一社)日本MRS、(公社)石油学会

日時：2019年1月10日(木) 12時45分～18時30分 (受付 12時00分開始)

会場：東京大学 武田先端知ビル 武田ホール

([http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda\\_map.pdf](http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda_map.pdf))

参加費：シンポジウム：一般、部会員ともに5000円(学生無料)、懇親会：一般、部会員ともに3000円

材料・界面部会では、各種材料プロセスを横断するような共通課題(基盤技術)について議論する場を継続的に提供しています。その議論の中から、各研究・技術における共通性を見だし、学会と産業界との連携を図り、基盤技術の体系化を図ることを目指しています。今年度は、接着・粘着技術から、構造接着、異種材料接着、接着プロセス技術、接着評価技術までを一連のトピックとして取り上げます。接着設計と管理に関する基礎現象の理解から接着技術の応用展開まで俯瞰的に捉え、広い分野に共通する基盤技術について議論をします。奮ってお申し込みいただきますようお願いを申し上げます。

### プログラム

---

開会の挨拶(12:45～12:50) 材料・界面部会長 同志社大学 塩井 章久 氏

①12:50～13:30 原賀康介 氏 ((株)原賀接着技術コンサルタント)

「接着技術の現状・課題と取り組み」

②13:30～14:10 若林一民 氏 (エーピーエスリサーチ)

「金属・プラスチックの異材接合：接着剤の正しい選び方と使いこなし」

③14:10～14:50 鈴木靖昭 氏 (鈴木接着技術研究所)

「金属の接着：ステンレス鋼の接着と評価」

休憩

④15:00～15:40 上坂一郎 氏 (日本プラズマトリート(株))

「大気圧プラズマを用いた接着」

⑤15:40～16:20 市川 功 氏 (リンテック(株))

「半導体用材料の要求仕様と精密解析による材料設計」

⑥16:20～17:00 田口哲志 氏 (物質・材料研究機構・機能性材料拠点)

「材料と生体との界面接着性制御による医療用材料の開発」

休憩

⑦17:10～17:50 秋山陽久 氏 (産業技術総合研究所・機能化学研究部門)

「可逆接着剤の開発と接着界面に関する研究」

⑧17:50～18:30 奥村治樹 氏 (ジャパン・リサーチ・ラボ)

「界面分析・評価：接着における制御・解析のための分析技術」

懇親会(18:45～20:15) 場所：東京大学 武田先端知ビル 武田ホール ホワイトエ

([http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda\\_map.pdf](http://www.denki.or.jp/committee/nuc/takeda_map.pdf))